

圣戈鲁 **SGLTEK** 8817XG 单组份导电银胶

不含溶剂，80~120°C固化，多种材料的高强度导电粘结



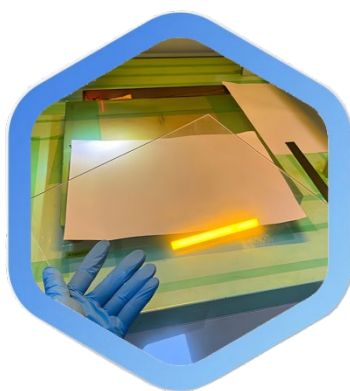
单组份不用混合，可80°C固化，实现导电连接
为难以焊接的材料提供高强度的导电粘结

加温固化型

1. 环氧导电银胶，**粘结强度高**
2. 可密封性粘结，**不含挥发性溶剂**
3. 可较低温度固化，**80~120°C固化**
4. 可粘结**金属、石墨、陶瓷、玻璃**
5. 耐温较高，**-50~280°C工作**
6. 操作时间较长，**7天@25°C**

圣戈鲁**SGLTEK** 8817XG 产品应用场景

单组份导电银胶：基于环氧树脂为粘结基材的银胶，较低的固化温度兼顾了良好的导电性能以及多种材料的高强度粘结, 并且可以在-50~280℃工作。



金属材料

产品的元器件在高温下提供稳定的导电粘结，电阻小，粘结力好。单组份易操作，点胶方便。

- ✓温控阀芯
- ✓医疗靶材
- ✓芯片焊接

非金属材料

环氧树脂为基体材料，可以粘结石墨，导电玻璃，陶瓷等材料，解决了不能焊接的问题。

- ✓石墨双极板
- ✓陶瓷、玻璃
- ✓声波换能器

One-Component Silver Conductive Adhesive

圣戈鲁SGLTEK 8817XG 与8827X 的区别

8817XG单组份操作方便, 无需混合; 8827X需现配现用, 但性能更佳

8817XR
价格较低

高温下导电好

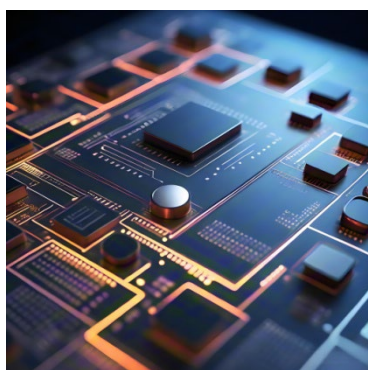
更高的银含量, 高温下导电能力更强, 适用于要求高的一些领域, 粘结强度也有进一步提升。双组份现配现用, 方便运输与存储。

VS

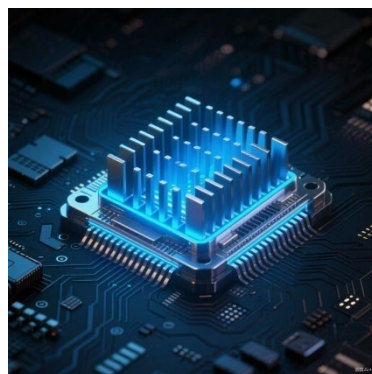
单组份易操作

冷冻保存, 使用前20~25°C密封状态下回温2小时, 即可使用。价格较低, 高温下稳定工作, 满足较多场合使用。

8827X
导电更好



工业化大规模使用



要求较高的领域使用

8817XG & 8827X的选择

圣戈鲁SGLTEK 8817XG 单组份导电银胶

Technical Data Sheet

产品概述： 该产品属于单组份环氧导电银胶，90℃加温固化，耐温280℃，低电阻率；能够代替锡焊，对金属，陶瓷，石墨, 导电玻璃等材料进行高强度导电粘结



产品指标：

项目	单位	8817XG	
外观	-	银色膏状	
密度	g/cm ³	2.8~2.9	
粘度	mpa·s (25℃)	32000~34000	
推荐固化时间	hr (90℃)	90℃*1小时固化	
可选择固化温度	-	120℃ 10分钟	
(性能略逊于推荐固化温度)		80℃ 2小时	
项目	单位	指标	测试方法
邵氏硬度	D	75-80	邵氏硬度计
导热系数	W/m·k	3	GB/T 3399
体积电阻率	Ω·cm	10 ⁻³ ~10 ⁻⁴	四探针
玻璃化温度 (Tg)	℃	96	GB/T 40396
热膨胀系数	<Tg	42	GB/T4339
	>Tg	150	
工作温度	℃	-55~+280	进行了3次循环，胶块不应开裂，性能仍符合要求
包装	10g/套 针管装；100g/套 瓶装		
产品保质期	-20℃保存12个月；25℃保存1个月		